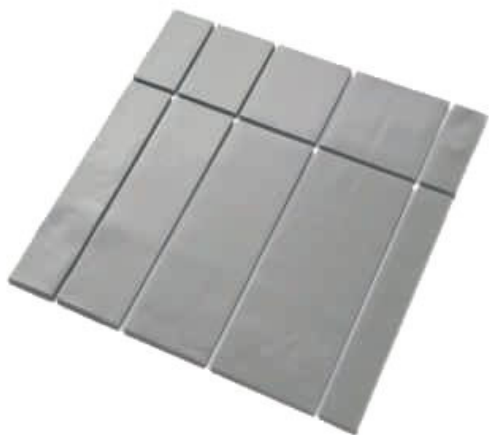




■ 产品用途

用于微处理器、功率半导体器件、固态继电器的散热

■ 产品特点

- 高导热率、低热阻的接触热阻
- 高压缩性、硬性可控
- 柔软性良好，能有效的排除界面的空气
- 不含硅油、无硅氧烷挥发
- 阻燃等级UL94V-0
- 符合欧盟ROHS指令要求

■ 产品规格

型号	导热系数W/m·K
BN-HS100	1.0
BN-HS200	2.0
BN-HS300	3.0